

微电子与集成电路技术丛书

国家集成电路人才培养基地专家指导委员会组编



IC Fabrication

微电子制造技术概论

严利人 周卫 刘道广 编著

Yan Liren Zhou Wei Liu Daoguang

徐秋霞 审

Xu Qiuxia



清华大学出版社

微电子与集成电路技术丛书

国家集成电路人才培养基地专家指导委员会组编

IC Fabrication

微电子制造技术概论

严利人 周 卫 刘道广 编著

Yan Liren Zhou Wei Liu Daoguang

徐秋霞 审

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书介绍和描述了集成电路工艺制造的成套工艺流程和各工艺单步的技术内容。对于流程的介绍,除举例和说明一般性流程特点之外,专有一章说明了流程调度实施的技术与算法;对于各工艺单步,首先根据各单项工艺技术的作用进行了粗略分类,在此基础上,从工艺原理、工艺设备技术特点、实践操作等不同侧面,进行了略做扩展的描述。

本书可作为集成电路制造相关专业的本科生和研究生教材,也可供相关专业人士参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微电子制造技术概论/严利人,周卫,刘道广编著.—北京:清华大学出版社,2010.3
(微电子与集成电路技术丛书)

ISBN 978-7-302-20818-1

I. 微… II. ①严… ②周… ③刘… III. 微电子技术—概论 IV. TN4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 156668 号

责任编辑: 陈志辉

责任校对: 李建庄

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印 张: 11.75 字 数: 284 千字

版 次: 2010 年 3 月第 1 版 印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 19.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:029267-01

《微电子与集成电路技术丛书》 编审委员会

顾问

丁文武(国家工业和信息化部)	王阳元(北京大学)
叶甜春(中国科学院)	包为民(中国航天科技集团公司)
冯记春(国家科技部)	吴德馨(中国科学院)
邬江兴(解放军信息工程大学)	许居衍(华晶集团)
严晓浪(浙江大学)	李志坚(清华大学)
张尧学(教育部)	郑南宁(西安交通大学)
郝跃(西安电子科技大学)	侯朝焕(中国科学院)
潘建岳(新思科技)	魏少军(清华大学)

主任

王志华(清华大学)

副主任

张兴(北京大学)	陈弘毅(清华大学)
洪先龙(清华大学)	姚素英(天津大学)
董在望(清华大学)	

审稿委员

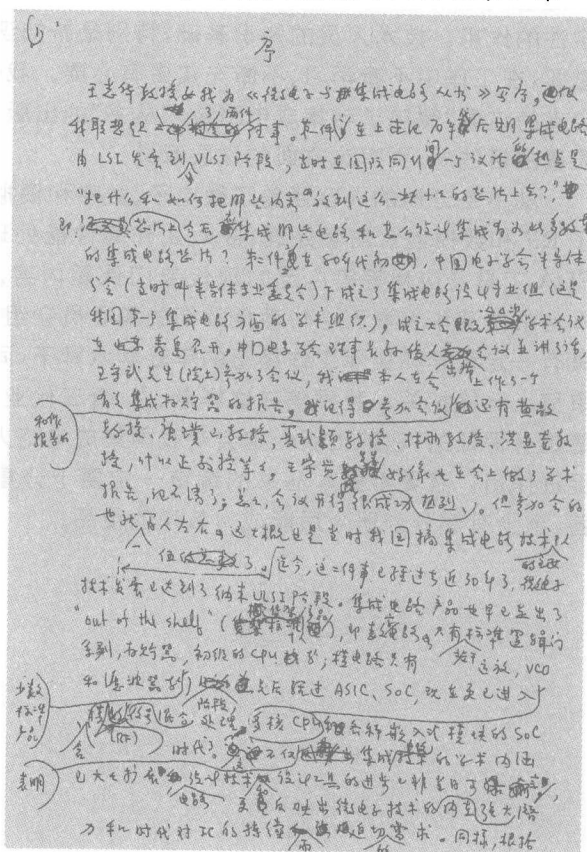
张建人(清华大学)	边计年(清华大学)
张大成(北京大学)	高明伦(南京大学)
闵应骅(中国科学院)	刘章发(北京交通大学)
徐秋霞(中国科学院)	陈贵灿(西安交通大学)
赵元富(航天 772 研究所)	吉利久(北京大学)
李斌桥(天津大学)	曾晓洋(复旦大学)

丛书秘书

朱秋玲(清华大学)

王志华教授要我为《微电子与集成电路技术丛书》写序,使我联想起了两件往事。第一件:上世纪70年代后期,集成电路由LSI发展到VLSI阶段,当时在国际同行间一个讨论的热点是:“把什么内容和如何把这些内容放到这么一块小小的芯片上去?”即今后芯片上应集成哪些电路和怎么设计集成有如此多电路的芯片?第二件:在上世纪80年代初,中国电子学会半导体分会(当时叫半导体专业委员会)下成立了集成电路设计专业组(这是我国第一个集成电路方面的学术组织),成立大会暨第一次学术会议在青岛召开,中国电子学会理事长孙俊人出席会议并讲了话,王守武先生(院士)参加了会议,我本人在会上作了一个有关集成存储器的报告,参加会议和作报告的还有黄敞教授、唐璞山教授、夏武颖教授、林雨教授、洪先龙教授、叶以正教授等等,记得王守觉先生也在会上作了学术报告。总之,会议开得很热烈、很成功。但参加会议的也就一百人左右,这大概也是当时我国搞集成电路技术的主要队伍。

迄今,这两件事已经过去近30年了,微电子技术已发展到了纳米ULSI阶段,集成电路产品也早已走出了out of the shelf的阶段,即数字电路只有若干标准逻辑门系列、存储器、初级的CPU等,模拟电路只有运放、VCO和滤波器等少数标准产品的阶段,先后经过ASIC、SOC,现今已进入了多核CPU、含射频、模拟与混合信号处理和各种嵌入式模块的SOC时代了。这不仅表明集成电路技术的学术内涵已大大扩展,电路设计技术和设计工具的进步已非当日可比,更反映出微电子技术的强大内在潜力和时代对IC的持续而迫切的需求。同样,根据中国半导体行业协会企业名册,我国有规模的IC设计企业已达到一百几十家,由此估计从业人员应该以万计算了,技术上我们已能独立设计出诸如3G手机核心芯片、嵌入式和高性能的CPU以及高档的保密芯片等产品,这表明我国的集成电路设计产业

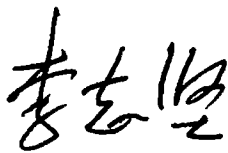


(李志坚院士为本丛书写的序言手稿)

和技术队伍也有了相应的很大进步。

微电子和集成电路是现代信息技术发展的基石,集成电路产业关系到国家的经济命脉、人民生活品质和国防与国家安全。作为现代主要高科技之一,集成电路技术方面的国际竞争十分激烈:谁的产品功能强、质量优、推出早、成本低,谁就占领主要市场,为胜者;谁落后一步,往往会被无情淘汰。夸大一些说,这一竞争往往是“只有第一,没有第二”。微电子和集成电路技术要求的基础知识十分广博,又与众多的高新技术相互交叉。集成电路产品更新换代极其迅速,产品从研制到投产周期日益缩短。这一切都决定了从业人员必须要有极高的业务素质,其中技术人员的基础知识、专业水平,特别是技术创新能力更有决定性的作用。技术人员的基础知识,特别是新知识的补充,越来越重要;不仅在学校学习很重要,在工作中不断学习、不断充实更有必要。我想,国家集成电路人才培养基地专家委员会支持这套“微电子与集成电路技术丛书”的出版,除了要达到提高在校学生专业课程教学质量的目的外,更有这方面的深层意义。

丛书各分册的内容涵盖了微电子、数字和模拟集成电路的基本原理和技术知识,还包括了RF和数模混合信号处理、嵌入式和高性能处理器、低功耗芯片设计、SOC设计方法学、EDA工具及应用等等广泛的现代专门课题内容。选题广阔、全面,符合与时俱进的精神。本丛书由清华大学王志华教授领衔的编委会组织编写,各册编写者主要是工作在第一线具有一定教学和实际工作经验的年轻学术骨干,同时聘请了一批国内同行中的资深专家为审稿人严格把关。我相信在这样老、中、青三代业内人士的共同努力下,本丛书的内容和质量是有保证的,它的出版一定会对我国集成电路人才培养和现有科技人员素质的提升起到促进作用。我更希望本丛书的编审一定要十分重视学术上的严谨性,并期盼,经过不断完善,至少有部分分册今后能成为教学的精品。



2010年1月10日

序二

我曾经说过,每当我拿起笔为年轻学者出版一套丛书或一本书写序的时候,心中总是怀有特别的喜悦,因为这意味着辛勤耕耘后的丰硕收获,也意味着年轻的学者在进步与发展的道路上又迈出了新的一步,所以我总是乐意而为之。

自1958年TI公司的Jack S. Kilby和1959年仙童公司的Robert Noyce发明集成电路和硅平面集成电路以来,50年间,微电子和集成电路技术可谓发展神速,如同摩尔规律(Moore Law)所描述与预期的那样,按存储器算,集成度每18个月翻一番;就微处理器而言,集成度每两年翻一番;相应特征尺寸则缩小为上一技术节点的0.7。当前集成电路的集成度已从发明时的12个元件(2个晶体管、2个电容和8个电阻)发展到今天的数十亿个元件。集成电路功能日新月异,而成本迅速降低,微处理器上晶体管的价格每年平均下降约26%。2006年,Intel曾发表了一个很有意味的广告词:“现在一个晶体管的价格大约与报纸上一个印刷字母的价格相当”。这就是说,人们只要买得起报纸,就消费得起集成电路。正因为如此,集成电路已广泛渗透到国民经济、国家安全建设和人民生活的各个领域,其应用的深度和广度远远超过了其他技术,是当代信息社会发展的基石。信息是人类社会三大资源之一,而且是目前利用得最不充分的资源。信息的本质是物质运动过程中的特征,信息技术包括信息的获取、传输、处理、存储、显示和随动执行等一系列的环节,而集成电路从狭义上讲则集信息处理、传输、存储等于一个小小的芯片中;从广义上讲,集成系统芯片(System on Chip, SOC)则集成了上述诸方面功能于一个芯片上或一个封装内的若干芯片(SiP)中,而这种可靠性高、功耗低的芯片又可以大批量、低成本地生产出来,因而势必大大地提高人们处理信息和应用信息的能力,大大地提高社会信息化的程度。它已如同细胞组成人体一样,成为现代工农业、国防装备和家庭耐用消费品不可分割的组成部分。集成电路科学技术的水平和它的产业规模也就理所当然地成为衡量一个国家或地区综合实力的重要标志之一,成为一个具有战略性的基础产业和高新科学技术领域。在过去的50年,在人类科学技术发展的沧海横流中,集成电路已经并正在不断显示其英雄本色。在人类社会步入信息化时代后,特别是在我国走“工业化带动信息化、信息化促进工业化”的具有中国特色的新型工业化道路中,在市场需求和国家中长期科学规划重大专项投入的双重促进下,我国集成电路科技和产业必将得到更多的发展机遇,带来更多的创新。

现代社会的科技竞争,包括微电子与集成电路技术的竞争,归根到底是人才的竞争。得人才者得天下,集人心者集大成,希望在人才。培育人才最重要的工作在于教育,只要人类社会存在,教育就是永恒的主题;只要人的生命存在,学习就是不竭的任务。不管是学校教育还是在实践基础上的自学进修都需要教材或称之为教本,所谓“教本、教本,乃教学之本”。

集成电路不是直接与消费者见面的最终产品,因而系统应用是使集成电路产生巨大增值的关键环节,而设计是微电子技术和集成电路产业链中最接近应用、也就是最接近市场的

领域,具有巨大的创新与市场空间。50年来集成电路的发展史是需求牵引和科学发现、技术发明推动相结合的历史,是一部技术创新和机制创新的历史。需求牵引往往由市场和系统应用提出,而设计首先就需要面对这种新的需求。一个好的算法、标准和设计往往可以引领市场的发展,为微电子和集成电路开拓一个崭新的领域。因此,“微电子与集成电路技术丛书”首批启动就将重点放在与设计相关的专业课程是十分恰当的。

《微电子与集成电路技术丛书》由国家集成电路人才培养基地专家委员会主持编写,第一批启动16册,第二批将再启动10余册,其内容涵盖了微电子及集成电路领域的主要范畴,尤以设计为主体。由年轻的学科带头人、清华大学王志华教授领衔丛书编委员会,参加编写的有30多位年轻的学科带头人和学术骨干,这反映了我国年轻一代学者正在茁壮成长。同时,丛书还邀请了一批治学严谨的年长一代科学家和学者担任审稿工作,在这些学者的名单中我看到了在上世纪80年代就曾共事过的如洪先龙教授、吉利久教授、张建人教授等老朋友。我坚信:由年轻学者执笔,由年长一代科学家把关,丛书学术内容的新颖性和严谨性就一定能得到可靠的保证。

这套丛书特别适合于微电子与集成电路专业高年级本科生、研究生阅读,也适合相关领域的工程技术人员作为参考书。我相信,阅读本丛书的学生和科技人员必将受益匪浅。



2010年1月5日于北京大学

序三

有一个古老的中国寓言,说的是一个年轻的读书人看到一位仙翁用手指点一下石头,石头就能变成金砖,这是成语“点石成金”的来源。多年后的今天,人们常常只关注到那腐朽化神奇的“一点”而忘了故事寓意中最重要的一环,即练得此法术的方法和为此所需要付出的数十年的功德和修为。自1995年我从业以来,就一直惊叹微电子及集成电路是一个多么像“点石成金”的行业,而同时又是一个多么讲究方法、多么需要付出艰苦努力的领域!

多年来我和我在 Synopsys 公司的同事们一起在国内推广基于逻辑综合的自顶向下的集成电路设计方法,经历了逆向设计解剖版图的初始阶段,那时全国设计业产值不过上亿元人民币、设计企业不过数十家、从业人员以百十计,而现在,中国大陆已是全球最大的集成电路市场、全国设计业产值超过300亿(依然是方兴未艾)、设计企业超过500家、从业人员数以万计;从那时开设集成电路设计课程并装备集成电路设计工具环境的寥寥几所高校,到目前19所院校建有集成电路工程特色专业、20个(含在建)集成电路人才培养基地、约40个大学招收集成电路工程硕士、近50个大学(所、系)配置了我公司的IC设计工具的大学计划包。这真是个天翻地覆的变化。IC设计是个智力密集型、创新密集型的行业。没有高素质、实践型的人才和人才培养支撑体系,就没有持续发展的可能。人才依然是我们发展过程中遇到的最大瓶颈之一,我们仍然感到缺少一套系统化的、覆盖该领域最新技术的微电子及集成电路教材。公司总部有一个教材指导委员会(Curriculum Advisory Board),他们基于多年的研究积累,针对本科生和研究生主持开发了一套微电子及集成电路课程体系,当我了解到相应的教学课程内容后,便立即想到如果以此为参考帮助国内开发一套微电子及集成电路领域的教材和参考书,应该是非常有意义的。此想法得到了时任国家集成电路人才培养基地专家委员会主任委员浙江大学严晓浪教授和委员会副主任委员清华大学王志华教授的赞同,也得到了 Synopsys 公司全球总裁陈志宽博士的积极支持。一年多后的今天,我们终于见到了这套丛书第一批16本的面世!这是主编王志华教授和30多位编审者们辛勤劳动的成果,也要感谢李志坚院士、王阳元院士这样德高望重的多位业界前辈对丛书编著选题的把握、对方向的关注、对内容的裁夺等。我也非常高兴我的同事和我的公司在这件事情上面所作的微薄贡献。

一直以来,参与并推动中国集成电路产业的腾飞是我们的梦想。回望过去,中国每一天都在进步,中国集成电路产业每一年都在成长。世界范围内产业的大迁移、国内市场需求的强劲拉动、有利的产业政策和创业环境,正带给中国集成电路产业发展最佳的契机。而人才

培养是最重要的环节和基础,是漫长的付出和努力、是艰辛的孕育和耕耘、是由量变到质变的积累,直到腾飞前的化蛹成蝶。在老中青几代人的共同努力下,相信在不久的将来我们的行业一定会创造出一座座的金山、一定会拥有一大批“点石成金”手!“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。我由衷地希望这套丛书的出版可以帮助实现我们共同的心愿,并殷切期待丛书下一批十多本著作的尽早面世!



2009年12月于北京

主编序言

潘建岳先生和我是清华校友,一直以来,他和他的同仁对国内集成电路行业的发展给予了极大的关注和支持。2007年初,时任 Synopsys 中国区总裁的潘建岳先生提出,将 Synopsys 公司教材指导委员会(Curriculum Advisory Board)主持开发的课程体系和一套以 IC 设计为主的教学课件赠送给国家集成电路人才培养基地专家委员会,期望对国内集成电路设计人才培养特别是教材建设有所帮助。当时,教育部和科技部已经批准在 20 所大学建立(含筹建)集成电路人才培养基地,国务院学位办已经批准在约 40 个大学招收集成电路工程领域的工程类硕士研究生,教育部也于 2007 年已经批准在 19 所院校建设微电子学专业集成电路领域的特色本科专业建设。除此之外,电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术等学科的高层次人才,也都需要具备集成电路知识。受潘建岳先生的建议及赠送的材料的启发,集成电路人才培养基地专家委员决定编写《微电子与集成电路技术丛书》并委托我担任主编。

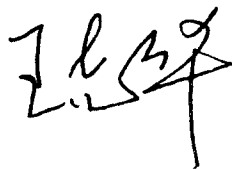
为做好丛书的编写工作,潘建岳先生和我一起专门拜访了王阳元院士,请求指导和支持。王阳元院士是我国杰出的教育家和科学家,为我国微电子事业的创立和发展做出了不可磨灭的功绩。得知我们计划编写一套《微电子与集成电路技术丛书》之后,王院士除了表示支持之外,还特别叮嘱我们关心图书的内容和质量。丛书要为读者提供完整的知识体系,提供正确和准确的技术内容,对于飞速发展和变化的微电子和集成电路领域,要力求反映最新的技术进展。但图书的价值,不仅体现在当前最新知识的传播上,在图书的技术内容过时之后,书籍依然承载着历史和文化的价值。

担任主编工作后我一直有一种忐忑不安的心情,主要是感到自己不足以把握日新月异的集成电路知识,更没有勇气面对王阳元院士讲的书籍的历史文化价值的承载作用。作为国家集成电路人才培养基地专家委员会中的一员,在诸多年高德劭的前辈的指派下,我诚惶诚恐地承担了这个任务。

我们邀请了国内在微电子和集成电路领域第一线工作的年轻学术骨干参加丛书编写。他们不但具有相当丰富的教学经验,而且活跃在相关科学研究的前沿,其中还有部分教师参加过国家集成电路人才培养基地专家委员会和国家外国专家局支持的技术培训。他们的知识、经验和奉献精神,是本丛书面世的基础;我们同时聘请了一批国内同行中的资深专家参加丛书编委会,他们除了为图书选题、内容取舍出谋划策之外,还作为审稿人对图书的技术内容、讲述方法甚至语言文字严格把关。他们的工作,不仅保证了图书编写质量,而且是对国内微电子和集成电路领域年轻才俊的大力扶持和帮助。感谢这些知识渊博、德高望重的前辈。感谢教育部高等教育司、科技部高新技术及产业化司、原信息产业部电子产品司的领导对图书编写和出版的支持,他们对教育、科技发展以及微电子行业需求的深入了解,使丛书的编写得以适应行业的需求。感谢浙江大学严晓浪教授,他作为国家集成电路人才培养

基地专家委员会的主任委员,始终关心和指导着丛书编写的各个环节。

现在,《微电子与集成电路技术丛书》第一批 16 种图书终于面世了!本丛书内容涵盖了微电子、数字和模拟集成电路的基本原理和技术知识,还包括了射频电路设计、数模混合信号处理、嵌入式和高性能处理器、低功耗芯片设计、SOC 设计方法学、EDA 工具及应用等广泛的现代专门课题内容。我们期望丛书不辜负微电子和集成电路领域专家的期望,以全面的选题、丰富的内容、准确的知识、科学的表述传播微电子和集成电路领域的知识,满足我国集成电路领域人才培养的需求。如果该丛书能为我国微电子和集成电路领域的科技发展作出点滴贡献,功劳属于图书的编写者以及为图书的面世贡献了力量的众多无名英雄。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王震' (Wang Zhen), written in a cursive style.

2009 年 11 月于北京清华园

前言

本书介绍集成电路制造技术,涉及制造流程和各具体的单项工艺技术。

当前,介绍集成电路制造工艺的一般书籍,均侧重于对各单项工艺技术的叙述;这些单项工艺包括氧化、扩散、LPCVD、离子注入、刻蚀、光刻、蒸发、溅射等,都是集成电路制造的基础性工艺。本书在描述这些单项工艺技术时,按照工艺在构成器件结构时所发挥的作用,对它们进行了分类和归并;在具体叙述某些特定工艺技术时,兼顾了实际的操作过程。

本书第1章是全书的概括,引入了微结构的概念及分类。集成电路是一种典型的微结构,含集成电路在内的各微结构构成种类繁多的一个大家族。

第2~5章,具体描述各单项工艺技术。微结构器件一般是由多个不同层材料构成的,生长这些不同材料层的工艺技术,构成了第2章的内容;原始生长出来的材料,在材料的特质、属性,以及几何尺寸等方面,往往还不是最终所要求的,因此需要对所生成的材料薄层进行进一步的改造,才能使之符合器件结构的要求,对于这样的一大类单项工艺技术的描述,形成第3、4章的内容;集成电路的加工制造,通常只是针对所暴露出来的材料薄层的某些局部进行的,在第5章描述了用于定位的工艺,通过定位工艺,限定了后续工艺处理的加工范围。

鉴于集成电路制造设备非常昂贵,从业人员人工成本比较高,产品尽早进入市场的需求迫切,如何提高设备和人员的效率成为关乎集成电路产品成败的关键因素,所以第6章介绍了直接与流程实施相联系的集成电路制造作业调度技术。集成电路制造作业调度可以看成是工艺技术体系向实际制造过程过渡的中间环节。

最后,第7章结合作者所在单位近年来对SiGe、应变Si等新材料开展的研究工作,介绍了新器件结构及相关的一些技术内容。

本书的写作过程中,参考了作者单位内部组织编写的微电子工艺教材;另外,作者单位的工艺工程师窦维治、曹秉军、韩冰、邢凯等也提供了部分资料,在此对他们表示感谢。

受限于书籍篇幅和作者水平,很多工艺没能进一步展开讨论,内容尚有未完善之处,望读者批评指正。

作 者

2009年6月

目录

第 1 章 集成电路制造技术概论	1
1.1 集成电路的发展历史与趋势	1
1.1.1 集成电路技术发展历史.....	1
1.1.2 ITRS 发展路线图及未来趋势	4
1.1.3 集成电路的分类.....	6
1.2 微结构的概念	8
1.2.1 MEMS 器件	8
1.2.2 生物芯片	11
1.2.3 量子器件与纳电子器件	14
1.3 微结构制造流程举例.....	16
1.3.1 Bipolar 工艺	17
1.3.2 CMOS 工艺	22
1.3.3 非主流微结构制造技术	26
1.3.4 后道封装技术及模块化技术	28
小结	30
参考文献	30
第 2 章 新材料生成类工艺	32
2.1 化学气相淀积.....	33
2.1.1 化学气相淀积原理	33
2.1.2 化学气相淀积的种类	34
2.1.3 化学气相淀积工艺设计原则	35
2.2 物理淀积.....	36
2.2.1 蒸发和溅射	37
2.2.2 涂覆	38
2.3 硅外延和多晶硅的化学气相淀积.....	39
2.3.1 硅外延	39
2.3.2 外延中引入掺杂剂	41
2.3.3 图形外延和选择性外延	41
2.3.4 硅外延中的缺陷	42
2.3.5 多晶硅的化学气相淀积	42

2.4	化学气相淀积 SiO ₂ 薄膜	42
2.4.1	化学气相淀积不掺杂 SiO ₂ 薄膜	42
2.4.2	化学气相淀积掺杂 SiO ₂ 薄膜	43
2.5	化学气相淀积氮化硅薄膜	45
2.6	金属化	46
2.6.1	铝薄膜淀积	47
2.6.2	钨塞	48
2.6.3	铜薄膜淀积	50
2.7	薄膜的台阶覆盖	51
2.8	薄膜测量	52
2.8.1	薄膜厚度的测量	52
2.8.2	薄膜电阻的测量	54
2.9	真空技术	54
2.9.1	真空的概念与划分	54
2.9.2	真空系统与真空泵	55
	小结	57
	参考文献	58
第3章 改变材料层属性的工艺(I)		59
3.1	热氧化	59
3.1.1	热氧化硅	59
3.1.2	热氧化工艺	61
3.1.3	热氧化对杂质再分布的影响	63
3.1.4	热氧化层中的电荷	64
3.1.5	热氧化硅在集成电路制造工艺中的应用	64
3.2	杂质扩散	65
3.2.1	杂质在硅中的扩散	66
3.2.2	Fick 扩散方程和杂质分布	68
3.2.3	杂质扩散与再分布	70
3.3	离子注入	70
3.3.1	离子注入原理	71
3.3.2	离子注入退火与杂质再分布	74
3.3.3	离子注入机的结构与分类	74
3.3.4	离子注入的其他应用	75
3.4	金属硅化物	76
3.4.1	金属硅化物的特性	76
3.4.2	金属硅化物的形成	77
3.4.3	金属硅化物在集成电路中的应用	80
	小结	80

参考文献	80
第 4 章 改变材料层属性的工艺(II)	82
4.1 刻蚀	82
4.1.1 刻蚀工艺简介	82
4.1.2 湿法腐蚀	83
4.1.3 干法刻蚀	85
4.1.4 SiO_2 刻蚀	86
4.1.5 多晶 Si 刻蚀	86
4.1.6 Si_3N_4 刻蚀	87
4.1.7 Al 刻蚀	87
4.1.8 高密度等离子体技术	89
4.2 刻蚀设备	90
4.2.1 刻蚀设备的总体结构	90
4.2.2 等离子体产生技术	91
4.3 刻蚀机的操作编程	95
4.4 其他的材料去除工艺	97
4.4.1 CMP 与减薄	97
4.4.2 改变材料属性工艺的作用强度	100
小结	100
参考文献	101
第 5 章 定位工艺技术	102
5.1 光刻工艺过程	102
5.1.1 光刻的作用、重要性与实现方法	102
5.1.2 曝光过程与摄影过程的比较	103
5.1.3 光刻技术的发展	103
5.1.4 光刻工艺过程	105
5.2 曝光原理	108
5.2.1 曝光光路	108
5.2.2 曝光系统的分辨率	108
5.2.3 相干及扩展光源成像	109
5.2.4 照明	112
5.2.5 焦深	112
5.2.6 影响曝光效果的光学效应	113
5.3 光刻机的结构组成	114
5.3.1 步进式光刻机的总体结构	114
5.3.2 空调腔室	115
5.3.3 灯室	115

5.3.4	版搬送机构和版台	115
5.3.5	硅片搬送机构和硅片台	116
5.3.6	激光干涉仪	116
5.3.7	镜头	116
5.3.8	性能指标	117
5.3.9	先进光刻机技术特点	118
5.4	光刻机的使用维护	118
5.4.1	使用与维护	118
5.4.2	制版	120
5.4.3	曝光作业编程	120
5.5	其他光刻工艺设备	122
5.5.1	HMDS 熏烘	122
5.5.2	涂胶机	122
5.5.3	显影机	122
5.5.4	镜检装置	122
	小结	124
	参考文献	124
第 6 章 流程运行调度技术		125
6.1	调度问题概述	125
6.1.1	一般性的调度问题	125
6.1.2	集成电路制造中的作业调度	126
6.2	流水线式调度	128
6.2.1	流水线式调度算法	128
6.2.2	调度算法与实例	132
6.3	流水线式调度特点及应用的讨论	136
	小结	138
	参考文献	138
第 7 章 新颖性工艺技术前瞻		139
7.1	SiGe 材料、器件与电路	139
7.1.1	SiGe 材料及技术	139
7.1.2	SiGe HBT 器件	141
7.1.3	SiGe HBT 器件的制造工艺	144
7.1.4	SiGe 平面集成工艺	149
7.2	应变硅材料与器件	150
7.2.1	应变硅的基本概念	150
7.2.2	应变硅技术及应用	151
7.3	ALD 工艺技术	154